

2013/09/26 05:06:40 ctanke

DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

適用規格		JEIDA Ver.4			
定格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C		保存温度範囲	-40 °C ~ +70 °C
	電圧(1)	1~68 : AC 125 V		使用湿度範囲	相対湿度95%以下
	電流(1)	1~68 : 0.5 A		(ただし、結露しないこと。)	

性 能		規 格	QT	AT
項 目	試 験 方 法			
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	○	○
	表示	目視にて確認する。		
電氣的性能	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20 mV 以下、1 mA で測定する。 [MIL-STD-1344A METHOD 3002.1]	○	-
	耐電圧 METHOD 301	AC 500Vrmsの電圧を1分間印加する。	○	-
	絶縁抵抗 METHOD 302	DC 500Vで測定する。	○	-
機械的性能	挿抜寿命 (オフィス環境)	毎時 400~600回の速度で、10,000回の挿抜を行う。	○	-
	振動・高周波 METHOD 204D	周波数 10~2000Hz、全振幅 1.52mm又は、 加速度 147m/s ² (g) で3方向各4時間の振動を加える。	○	-
	衝撃 METHOD 213B	加速度 490m/s ² 、持続時間 11msの正弦半波で 3方向各 3回の衝撃を加える。	○	-
環境的性能	熱衝撃 METHOD 107G	温度 -55 → +5 ~ +35 → +85 → +5 ~ +35 °C 時間 30 → 最大5 → 30 → 最大5分 で 5サイクルの嵌合放置をする。 (後処理：室温に1~2時間放置)	○	-
	湿度 (定常状態) METHOD 103B	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に96時間の嵌合放置をする。 (後処理：室温に1~2時間放置)	○	-
	硫化水素ガス	温度 40±2°C、約80%RH 3ppmのガス中に96時間の嵌合放置をする。(後処理：室温に1~2時間放置) [JEIDA-38]	○	-
	塩水噴霧 METHOD 101D	温度 35±2°C、5±1%の塩水噴霧中に48時間の嵌合放置をする。(後処理：塩の付着物を水洗い後、室温に24時間放置)	○	-

備考 注(1) 「 ~ 」は端子No.を示す。	製 図 PCC 04.02.23 佐藤	担 当 PCC 04.02.23 杉村	検 図 PCC 04.2.24 小沢	承 認 PCC 04.2.24 秋山	出 図
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----

試験規格の記載のない試験方法は MIL-STD-202Fを適用している。

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品規格表	製品名 IC1FB-68PD-1.27DS(72)
---	--------------	------------------------------

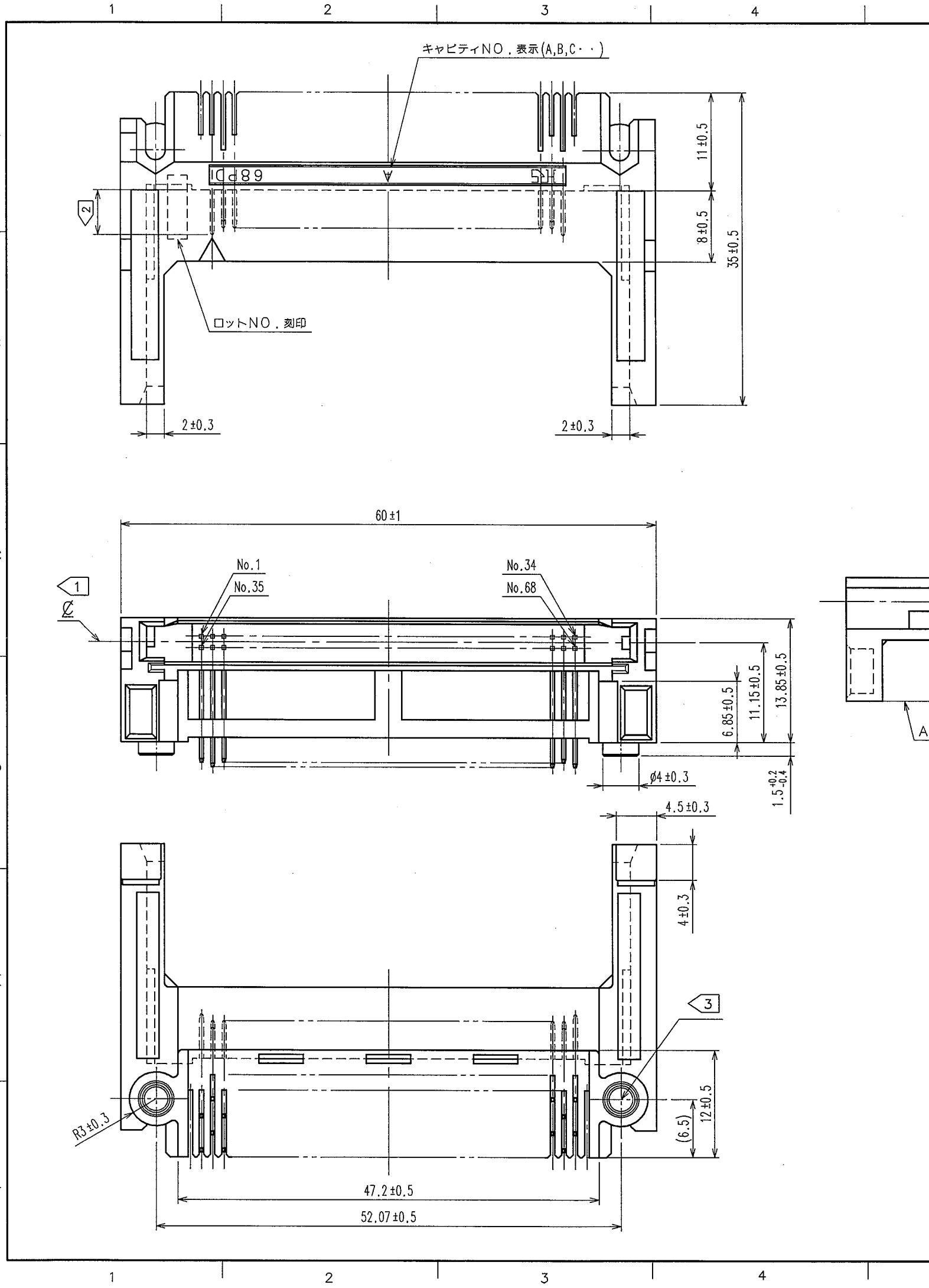
旧CL CL	図番 SLC4-083623-03	製品コード CL640-0025-0-72	1 1
-----------	----------------------	--------------------------	--------

TO
PCK

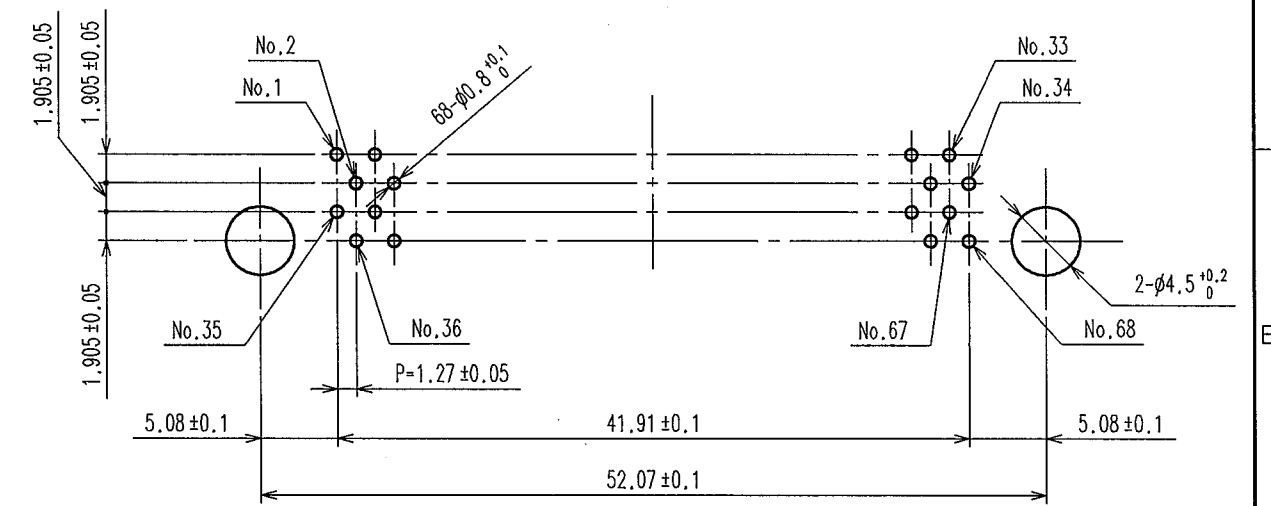


2013/09/26 05:06:40 ctanke

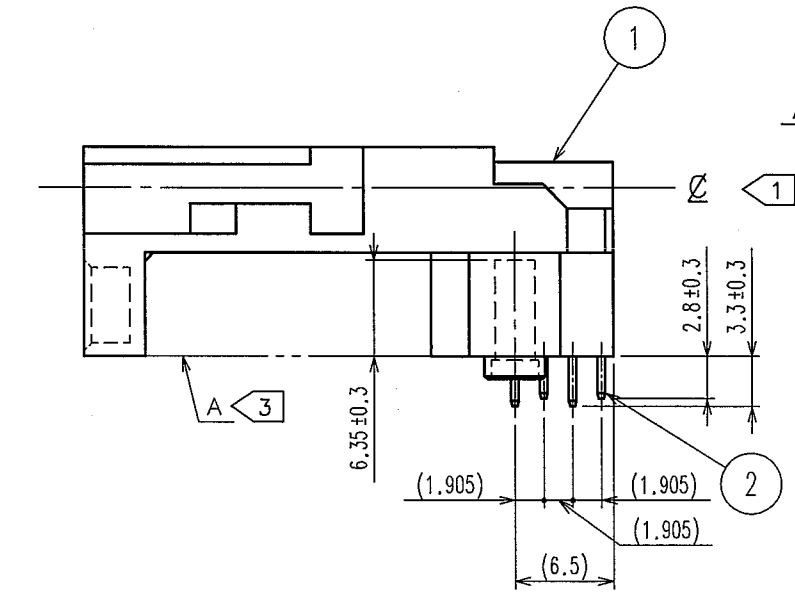
DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice



Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					△				
△					△				
△					△				



↑
カード挿入側
バックボード寸法図(実装面側)



注 ①φは3.5%の中心線を示します。
 ②カード嵌合部の寸法は『PC Card Standard』に準じています。
 ③タッピングねじはJIS-B-1007の2種、
 呼び径3相当で基板上面(A面)より5~6mm
 突出する様選択して下さい。

2	黄銅	(接触部)Ni2.5μm+Au0.2μm (実装部)Ni2.5μm+Sn2μm
1	PBT樹脂	クワ UL94V-0
部番	材質	処理,備考

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-083623-03	製品名 PART NO. IC1FB-68PD-1.27DS(72)			
尺度 SCALE 2:1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL640-0025-0-72			
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		1/1			

TO
PCK